

【産業機器】

ラッピングテープ（固定砥粒）を使用したウエハーの平坦化研磨装置 登録番号19-143

〔技術・製品の概要と特徴〕

ラッピングテープを使用してウエハーおよびデバイスウエハー層間膜表面の全面精密平坦化を実現した研磨装置。従来は、遊離砥粒によるCMP（ケミカルメカニカルポリッシング）平坦化方法が適用されてきているが、加工条件を一定にするため頻繁にドレッシングが必要になることから全面平坦化は難しいのに対して、ラッピングテープ方式は研磨テープを一定速度で送るだけのため全面平坦化が容易にできるほか、作業工程の短縮、作業環境の改善が図れる。



〔用 途〕

- ①ウエハー酸化膜の除去研磨
- ②ウエハー配線金属膜の平坦化

〔希望する技術移転の①形態・②相手先・③地域〕

- ①共同研究開発
- ②大企業から中堅企業（半導体製造企業）
- ③国内・外いずれでもよい

〔開発段階〕

実験（未了） 製造・販売実績（無）
関連特許(有)

〔提供可能資料など〕

パンフレット